

康平科技（苏州）股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第四届董事会2021年第二会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度基本情况

根据公司发展战略规划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请总计不超过35,000万元或等值外币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

本次授信用途包括但不限于：流动资金贷款、各类保函、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等银行合规融资相关业务。上述授信额度不等同于公司及子公司实际发生的融资金额，公司及子公司将根据实际业务需求办理相关业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

在上述授信期限和额度内，公司董事会提请股东大会授权董事会授权董事长或其授权人员签署与授信相关的各项法律文件，公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第四届董事会2021年第二次会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021年4月10日